

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-73

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
活动参与人员（排名不分先后）	国投证券、泓德基金、中欧基金
上市公司接待人员	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
时间	2024年12月3日
地点	国投证券策略会举办地
形式	实地调研
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。</p> <p>伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化，新一代信息技术产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切，驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求均受到上述趋势的影响。</p> <p>Q2、请介绍公司 PCB 业务主要产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心（覆盖无线侧及有线侧通信），重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子（聚焦新能源和 ADAS 方向）等领域，并长期深耕工控、医疗等领域。</p> <p>Q3、请介绍公司对汽车电子市场的布局逻辑以及技术优势。</p>

与传统汽车电子产品相比，公司所聚焦的新能源和 ADAS 领域对 PCB 在集成化等方面的设计要求更高，工艺技术难度有所提升。例如 ADAS 领域相关产品对车载通信及数据处理能力要求更高，涉及高频材料、HDI 工艺、小型化等复杂设计。伴随汽车电动化/智能化趋势的延续及未来车联网等终端应用的涌现，汽车也可能演变为新型的移动数据终端，公司在通信领域积累的技术优势可进一步延伸。

Q4、请介绍公司 PCB 业务后续扩产规划。

公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，已在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前基础工程建设有序推进中，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。另一方面，公司在南通基地尚有土地储备，具备新厂房建设条件，南通四期项目已有序推进基建工程，拟建设为具备覆盖 HDI 等能力的 PCB 工艺技术平台。公司将结合自身经营规划与市场需求情况，合理配置业务产能。

Q5、请介绍公司在封装基板领域的布局情况及当前能力水平。

公司自 2008 年以来对封装基板业务进行孵化，从细分领域产品做起，是中国封装基板领域的先行者。公司封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，并与多家全球领先厂商建立了长期稳定的合作关系，在部分细分市场上拥有领先的竞争优势。另一方面，针对 FC-BGA 封装基板产品，公司通过近年来持续的技术研发工作，已实现部分产品的技术能力突破，相关客户认证及产能建设工作取得进展。目前，公司已成为内资最大的封装基板供应商。

Q6、请介绍公司 FC-BGA 封装基板产品特点以及主要应用场景。

FC-BGA 封装基板具备高多层、高精细线路等特性，主要应用于搭载 CPU、GPU 等逻辑芯片，芯片产品具体应用场景取决于客户自身需求。

Q7、请介绍广州封装基板项目连线爬坡进展。

公司广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度连线，产品线能力在今年上半年快速

	提升，目前其产能爬坡尚处于前期阶段，重点仍聚焦平台能力建设，推进客户各阶产品认证工作，其认证周期相较其他 PCB 及封装基板产品所需时间更长。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。
附件清单	无